

# ErsaVERSAFLOW 3/66

## 模块化平台设计的在线性高产能 选择焊



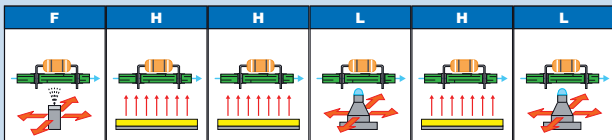
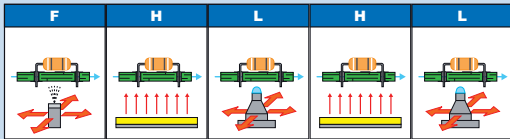
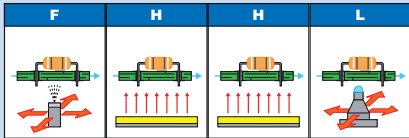
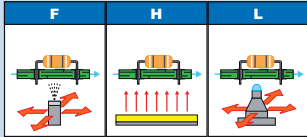
另请参考我们的独立  
目录 - 具有最大灵活  
性的选择焊



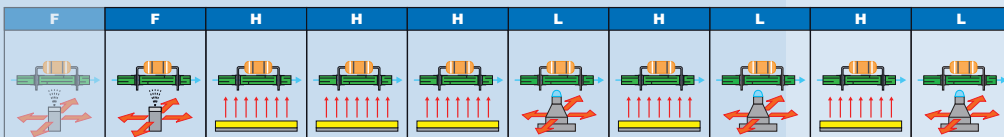
# Ersa 模块化系统

## 总有一种组合能满足您的工艺与预算要求

以下通过不同模块的排列组合来说明 Ersa 模块化系统的卓越灵活性。根据不同的客户需求，选用双锡缸和/或双轨道运输功能，可以大幅提高产能而无需增加占地面积。

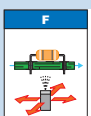


### 最大配置

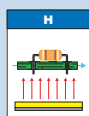


1,100 mm   750 mm   750 mm   750 mm   750 mm   1,100 mm  
1,300 mm   750 mm   1,100 mm   1,300 mm   750 mm   750 mm

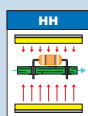
图解：



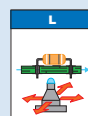
配备助焊剂喷涂装置的助焊剂模块



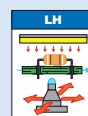
配备按钮部预热装置的预热模块



预热模块配备底部和顶部预热装置

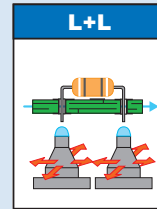


配备单点波峰单元的焊接模块焊接模块



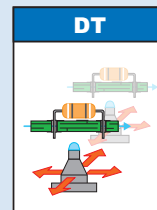
配备单点波峰单元和顶部预热装置

### + 双锡缸选项



相邻示例的不同配置都是以一个单喷嘴的焊接模块 (L) 为基础。该焊接模块也可选择加配一个锡缸和一个焊接喷嘴 (LL)。

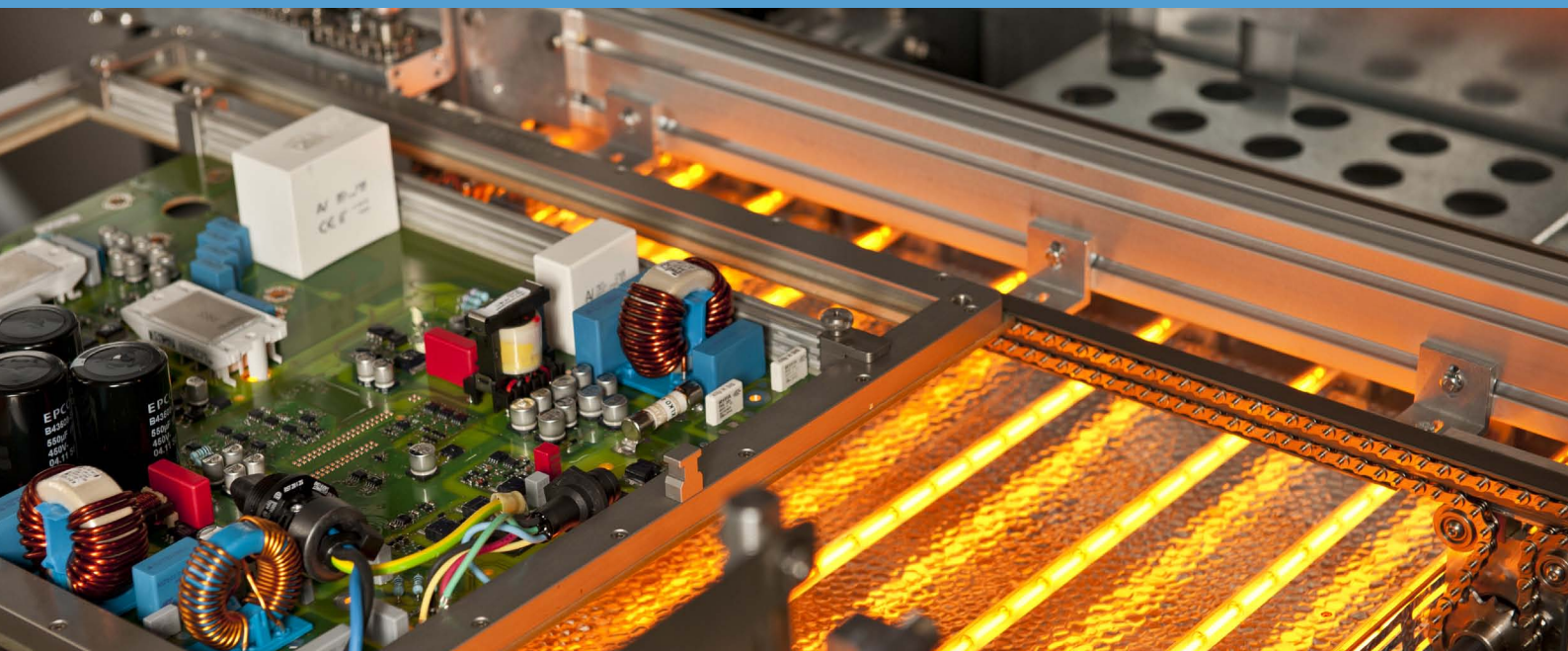
### + 双轨道传送选项



再增加一个轨道 (DT)，产能将翻倍。如果系统配备 2 个单喷嘴锡缸，则可同时处理两个完全相同的电路板组件。

# Ersa VERSAFLOW 3/66

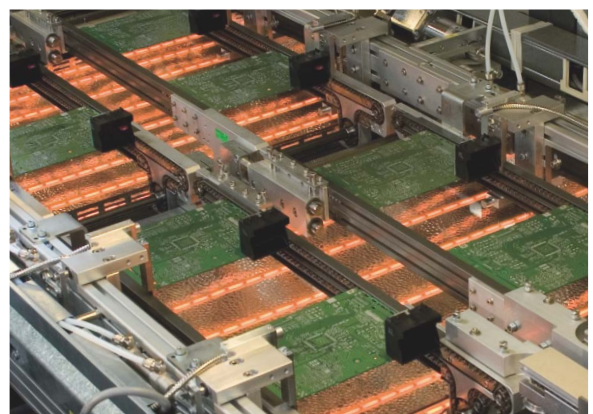
## 可实现最佳选择焊工艺的全球最优选择焊系统



为满足灵活性要求，Ersa 第三代 VERSAFLOW 的设计采用了完全模块化的机器平台来实现。VERSAFLOW 3/66 的基本配置由通常的助焊剂、预热和焊接模块以及一个分段式输送带系统组成。用户可根据具体应用和所需的产能，集成其它助焊剂/预热/焊接模块。在最高配置中，VERSAFLOW 3/66 的最高配置可包含多达 3/66 个焊接模块，每个模块还可配备 2 个单点波峰锡缸。每个焊接模块的上游可安装一个预热器。

除了可以安装多个单点波峰锡缸之外，还可以安装多点波峰锡缸。在预热区中以及单点波峰锡缸上方，可选装顶部热风对流预热。

选择双轨机型时，系统产能翻倍，但不会增加占地面积。而且，如果 PCB 的尺寸合适，预热器分段配置后，则还可以进一步提高产能。将所有选项都用上即可得到最高配置的系统，此时，系统中的不同位置最多可同时处理 22 块 PCB。



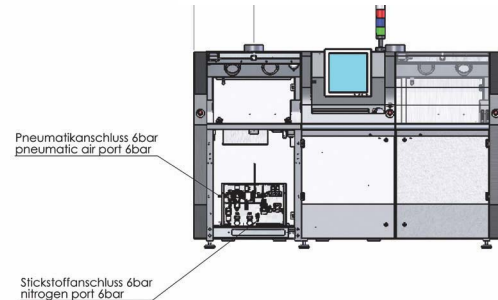
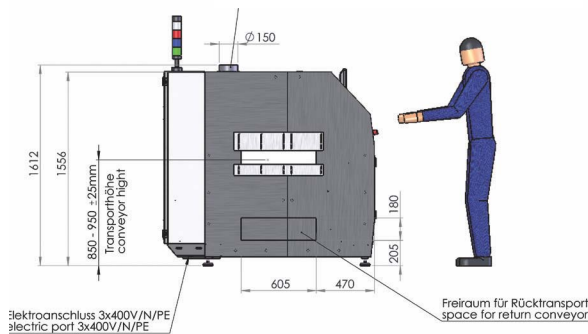
双轨可使产能翻倍而不增加占地面积

最上方图片  
底部动态预热和顶部动态预热的完美结合

封面  
VERSAFLOW 3: 可满足最高的产能和灵活性要求的双锡缸选择焊系统

# Ersa VERSAFLOW 3/66

## 技术参数和机器选项



### 尺寸 (基本配置):

长度:	2,950 mm / 116.1"
宽度:	1,900 mm / 74.8"
高度:	1,620 mm / 63.8"
重量 (不带焊锡):	约 1,700 kg / 3748 lb

### 涂装:

颜色:	RAL 7035 / RAL 7016
-----	---------------------

### 传送带系统:

类型:	用于不带焊接载具的 PCB 传输的分段式销链/滚轮传送带
传送带角度:	固定为 0°
PCB 宽度 (单轨):	63.5 – 610 mm / 2.5" – 24"
PCB 宽度 (双轨):	2 x 60 – 304 mm / 2.4" – 12"
PCB 长度:	127 – 610 mm / 5" – 24"
PCB 顶部净空:	最大 120 mm / 4.7" (从 PCB 底部测量, 不包括边隙 (3 mm))
PCB 底部净空:	最大 30 mm / 1.2" (根据 Ersa 布局指南), 根据客户要求可 > 30 mm / 1.2"
与 PCB 板边的净空:	3 mm / 0.1"
传送带离地高度:	850/950 mm ± 25 mm / 33.5/37.4" ± 1"
传送带速度:	0.2 – 10 m/min / 7.9 – 393.7"/min
阻焊托盘/PCB 重量:	最大 5 kg/11 lb

### 助焊剂模块:

类型:	高精度助焊剂喷涂器
定位系统:	2 轴 (X/Y), 伺服电机驱动
助焊剂储存罐:	2L
定位速度:	2 – 400 mm/sec / 0.1" – 15.7"/sec
助焊剂涂敷速度:	2 – 400 mm/sec / 0.1" – 15.7"/sec
定位精度:	± 0.25 mm / ± 0.01"
喷涂宽度:	2 – 8 mm (130 / 270 μm 内部喷头) / 0.1" – 0.3"

### 焊接模块:

类型:	不锈钢锡缸, 集成在 3 轴定位系统 (X/Y/Z) 中, 伺服电机驱动
焊接喷嘴:	单点高精度锡波
最小喷嘴直径:	OD ø 4.5 mm / 0.2" (可根据需要提供其它尺寸的喷嘴)
锡波高度:	最大 5 mm / 0.2"
与 PCB 板边的净空:	最小 3 mm / 0.1"
焊料量:	~ 14 kg / 24.3 lb (Sn63Pb); ~ 13 kg / 22 lb 无铅
锡缸温度:	最大 320 °C / 608 °F
锡缸预热时间:	75 分钟 (直到 280 °C / 536 °F)
定位速度:	X/Y: 2 – 200 mm/sec; Z: 2 – 100 mm/sec
焊接速度:	2 – 100 mm/sec / 0.1" – 3.9"/sec
定位精度:	± 0.15 mm / ± 0.006"

### 预热模块: (基本机器)

类型:	使用短波红外加热器进行底部加热
电源:	最大 22 kW
温度范围:	0 – 200 °C / 0 – 392 °F

### 氮气技术:

氮气供应:	本地供应
氮气注入:	锡缸上的 N2 盖
所需压力:	6 bar / 43.5 PSI
氮气消耗量:	每个锡缸约 1.5 m³/h / 2 yd³/h
要求的纯度:	平均为 5.0

### 气动系统:

压缩空气供应:	本地供应
所需压力:	6 bar/87 PSI
消耗量:	< 5 m³/h / 6.5 yd³/h

### 控制:

PC 控制系统:	Windows 7 操作系统
工艺可视化	所有工艺参数输入
7 天计时时钟	
机器状态控制	
密码功能	
工艺数据记录	
超重传送带系统, 最重可达 18 kg	

### 电气参数:

电源:	5 线制, 3 x 230/400 V, N, PE
电源容差范围:	+6 %, -10 %
频率:	50 / 60 Hz
功耗:	30 kW (基本机器)
电流:	50 A (基本机器)

### 排风额定值 (基本配置):

每个排风口的排风量:	约 300 m³/h / 392.4 yd³/h
排风口:	2 个排气管, 每个的外径为 150 mm/5.9"

### 环境参数 (运行):

环境温度:	15 – 35 °C / 59 – 95 °F
-------	-------------------------

### 噪音:

持续噪音等级:	< 60 dB (A)
---------	-------------

### 基本设计与结构:

固体钢结构
安全玻璃窗
急停按钮